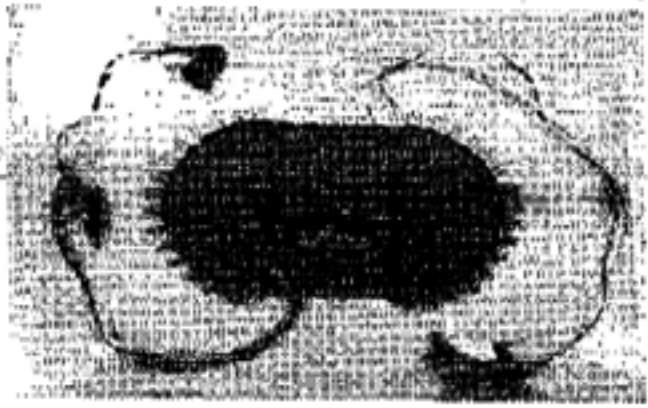


長、03・5452・5475)は、光伝送路を1本から8本に増やした光電混在基板(写真)を試作した。光電混在基板は、プリント基板上のLSI間の通信に光信号を



使い、毎秒10ギタ(ギガは10億)の速さで伝送する。電気配線と比べて3倍以上の高速大容量通信が可能。今回の試作品は光伝送路を8本に増やした同80ギタの伝送に成功した。東京・有明の東京ビッグサイトで16日開幕した展覧会「ファイバーオプティクスEXPO」に出品した。

光伝送路8本の 光電混在基板

先端フォトニクスが試作

先端フォトニクス(東
京都大田区、重松誠社